

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請見「業務 — 戰略」。

[編纂]用途

假設[編纂]未獲行使，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]及其他估計[編纂]開支，並假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即最高[編纂]）後，我們估計將自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]港元。為配合我們的業務戰略及發展，我們擬將[編纂]按以下金額用於以下用途：

- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元將用於提升我們的研發及創新能力。我們視自主研發和創新為核心發展戰略，並計劃保持高水平的研發投入，不斷提升產品性能。特別是：

- (i) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於保留、擴充及優化我們的研發團隊。半導體行業的特點是技術迭代快及其人才密集性質。為保持競爭力，我們計劃吸引和保留高水平的研發人才，建立一支具有國際視野和強大系統工程能力的優秀團隊。截至2025年12月31日，我們已建立一支由192人組成的研發人才團隊，佔總員工人數的75.0%。為應對智能視覺終端、智能車載、AR/VR和AI & HPC等領域需求的持續增長，我們計劃將增聘研發人才，以確保我們的持續創新及競爭力。我們預期該等研發人員普遍具備碩士或以上學位，並擁有微電子學、集成電路設計、電子工程、電腦科學或其他相關學科的學術背景。下表載列各職位所需的研發人員人數：

研發崗位	人數
數字IP設計工程師	11
IC版圖設計工程師	8
模擬IP設計工程師	8
數字IP集成工程師	6
FPGA驗證工程師	5
軟件工程師	4
數字驗證工程師、算法工程師、硬件工程師、 硅驗證工程師	3 (每個職位)
汽車模擬IP設計工程師	2
產品經理、時鐘設計工程師、測試工程師、 Linux驅動開發工程師、ATE測試開發工程師	1 (每個職位)
總計	61

- (ii) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用作提升我們的研發基礎設施。具體而言，我們計劃在合肥經濟技術開發區新建一個研發中心，總規劃建築面積約93,700平方米。該中心將致力於拓展智能視頻芯片及互連芯片的組合，並強化我們在智能汽車、AR/VR及高性能AI計算等高增長應用領域的技術能力。研發中心的工程已於2025年11月動工，主體結構將於2026年9月封

未來計劃及[編纂]用途

頂，設施計劃於2027年12月投入運營。同時，該等[編纂]亦將用作購置先進設備及工具，包括(a)芯片可靠性測試儀器，(b)實驗室設備，(c)計算硬件，及(d)軟件及知識產權。該等投資旨在提高我們的研發效率、加速產品迭代並加強我們的技術能力；及

- (iii) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於採購研發消耗品及原材料，包括原型開發及測試所用的印刷線路板及電子元件。該等投資將支持新芯片設計的開發、測試及驗證，確保產品質量及可靠性。
- [編纂]淨額約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於進一步豐富我們的產品矩陣及拓展下游應用場景。特別是：
 - (i) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於提升我們在AI & HPC領域的競爭力並加速這些應用產品種類的商品化。我們的產品路線圖旨在包含更廣泛的高速信號轉換和互連解決方案，以滿足下一代計算系統的嚴苛要求。我們計劃繼續投資於PCIe、SATA及USB等高速協議芯片的研發，以滿足AI訓練、推理及邊緣運算情境中不斷增長的數據吞吐量需求；及
 - (ii) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於擴展我們在新興應用領域的業務，包括智能車載領域及AR/VR領域。我們將繼續在車載娛樂系統、座艙顯示器、HUD、ADAS視頻採集和傳輸SerDes、多工顯示器傳輸SerDes、車用級面板和驅動器、音頻傳輸SerDes以及麥克風和揚聲器等領域拓展汽車級芯片和解決方案。我們亦致力於提升產品效能、整合度及功耗管理，以滿足不斷演進的超低延遲傳輸、超低功耗及微型化需求，並同時推動端側空間計算芯片的研發，以滿足「所見即所得」人機互動的極低運算延遲需求。
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於擴大我們的海外業務網絡及提升我們在國際市場的佔有率。我們的海外目標市場包括日本、韓國、美國、東南亞及歐洲。我們選擇這些市場的若干原因包括：(a)這些國家和地區經濟發達或成長迅速，客戶群廣泛，涵蓋消費、工業、醫療和汽車等領域；(b)該等市場擁有眾多全球知名品牌、下游晶圓廠商和創新公司；(c)根據弗若斯特沙利文的資料，我們所有目標海外市場在2025年至2030年間將繼續增長，複合年增長率介乎2.1%至6.2%。我們認為，該等因素顯示出具有吸引力的成長前景和市場機會，可進一步擴大我們的客戶基礎和深化我們的市場佔有率。有關我們海外市場的競爭格局，請參閱「行業概覽 — 行業競爭分析」。對於該等市場，我們計劃主要就視頻會議、AR/VR、攝像頭、汽車電子、商顯及醫療領域等應用場景的需求提供智能視頻芯片及互連芯片。我們亦委聘日本及韓國本地的經銷商，推廣我們的產品，並計劃提供進一步經銷商培訓及合作，擴大客戶覆蓋範圍及發掘其他商機。於東南亞、歐洲及美國，除現有客戶開發渠道外，我們計劃在適當時

未來計劃及[編纂]用途

機引入市場佔有率高且實力雄厚的經銷商，以為我們的產品推廣與客戶獲取提供支持。我們還計劃利用海外平台，謹慎增配技術及銷售資源，以提升國際市場的覆蓋率，並改善營銷及推廣的效果。

除此之外，該等資金將用於加強與國際芯片製造商的合作關係、優化全球客戶服務網絡及建立涵蓋國內外晶圓廠的雙軌道供應體系。物色晶圓廠合作夥伴時，我們擬優先選擇國內外頂尖主流晶圓廠，該等廠商的製程技術能力契合我們的技術路線圖與產品開發策略。我們的合作框架預期仍將主要以傳統供應鏈採購安排為基礎。視乎市況、技術成熟度及項目實施進度，我們計劃於2026年至2027年期間、2027年及2028年分別引入28納米與14納米製程節點、22納米製程節點及8納米與12納米製程節點。

- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用作在全球半導體行業內進行戰略性投資及收購。我們計劃有選擇性地識別及整合半導體行業的公司或資產（具有較強的技術能力、明確的商業化前景及與我們具有潛在的戰略合作），以擴展我們的技術及產品組合及加強我們的市場佔有率及渠道能力。於評估潛在目標時，我們將考量以下四項標準：(a)在高解析度影音連接能力、汽車電子、新世代顯示技術或高效能運算等領域，擁有不少於三項核心知識產權或關鍵專有技術；(b)具備互補性的產品組合與技術能力，足以強化我們的系統級解決方案；(c)展現強大的研發能力，其研發人員佔總員工數比例不少於50%；及(d)具備商業可行性與成長潛力，包括年度收入不低於人民幣20百萬元。透過此類投資，我們旨在整合互補技術、知識產權組合、產品組合、供應鏈資源及客戶群，從而提升我們的技術能力、鞏固市場地位，並增強「平台＋生態系」戰略的協同效應與競爭力。根據弗若斯特沙利文的資料，目前約有30個符合我們標準的潛在目標。截至最後實際可行日期，我們並無物色到任何特定目標或就任何潛在目標參與任何商業談判或訂立任何諒解備忘錄或意向書。
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用作營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]淨額低於預期，我們將按比例調整上述目的的[編纂]淨額的分配。

倘我們發展計劃的任何部分因政府政策變化導致我們任何項目發展不可行或發生不可抗力事件等原因而未能按計劃進行，我們將謹慎評估情況並可能重新分配[編纂]的[編纂]淨額。

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂]淨額並未即時用於上述用途，在相關法律法規允許的情況下，本集團會將未動用的[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他獲授權金融機構（定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區的適用法律法規）的短期計息賬戶。